

2026年3月期 決算説明資料

2026年6月12日



東証スタンダード 証券コード：6614



1. 事業セグメントと半導体業界での位置付け
2. 2026年3月期決算の概要
3. 2027年3月期通期業績予想の概要
4. 中期経営計画の進捗



1

事業セグメントと半導体業界での位置付け

- 電子システム事業・マイクロエレクトロニクス事業・製品開発事業の三つの事業を半導体とソリューション分野で展開
- 各事業において**ニッチTOPシェア**商品を保有

製品開発事業

産業用組込カメラ
国内トップシェア

※当社調べ

組込カメラモジュール、画像システム

CMOSカメラモジュール、見守りシステム
画像処理モジュール・カスタムカメラ開発



マイクロエレクトロニクス事業

JPEG IP
W/Wスマホ 20%

半導体設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、
画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、
IPコア：JPEG、MIPI、ISP



セグメント別
売上高構成

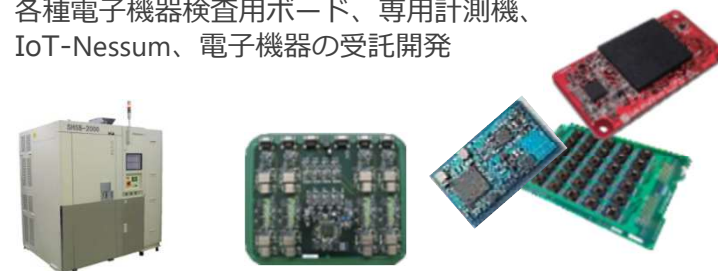
電子システム事業

車載向けBI装置
国内トップシェア

※当社調べ

半導体検査装置、専用計測機器

バーンイン装置・ボード、カスタムバーンイン装置
各種電子機器検査用ボード、専用計測機、
IoT-Nessum、電子機器の受託開発



バーンイン

半導体の初期不良を除去する選別方法の一種
半導体を通常より高温環境下で動作させる試験

IPコア（Intellectual Property）

LSIを構成するための部分的な回路情報のうち
特に単一機能でまとめられたもの

半導体業界での当社位置づけ

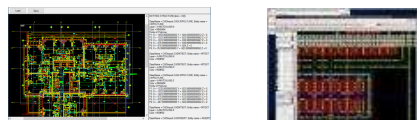
前工程

後工程

回路設計

半導体ウェハに回路形成

テスト パッケージング



垂直統合型半導体メーカー

プロセッサ&マイコン	メモリー	アナログ・パワー	イメージセンサー
インテル、ルネサス、STマイクロ、NXP	サムスン、SK、マイクロン、キオクシア	TI、インフィニオン、東芝、ローム、富士電機、デンソー	ソニー、オムニビジョン、etc

水平分業型半導体メーカー

ファブレス半導体メーカー	ファウンドリー	OSAT
Apple、Qualcomm、NVIDIA、AMD、Broadcom、Mediatek、ソシオネクスト	TSMC、UMC、Global Foundry、SMIC、Tower、TPSCo、etc	ASE、Amkor、etc

回路ブロック開発 (IPベンダー)
ARM、Synopsys、Cadence **シキノハイテック** **マイクロエレクトロニクス**

回路ブロック設計 (受託開発・人材派遣)
TOPPANテクノロジーデザインセンター、NSW メイテック、**シキノハイテック** **マイクロエレクトロニクス**

設計用システム (EDAベンダー)
Synopsys、Cadence、Mentor、JEDAT

製造装置
Applied Materials、ASML、Lam Research、東京エレクトロン、KLA、Screen、Canon、Nikon、国際電気、レーザーテック

材料
信越化学、SUMCO、東京応化、富士フィルム、凸版印刷、大日本印刷

製造装置
ディスコ、東京精密

検査装置
アドバンテスト、Teradyne、**シキノハイテック** **電子システム**

材料
京セラ、新光電気

※青太文字は日本企業



2

2026年3月期決算の概要

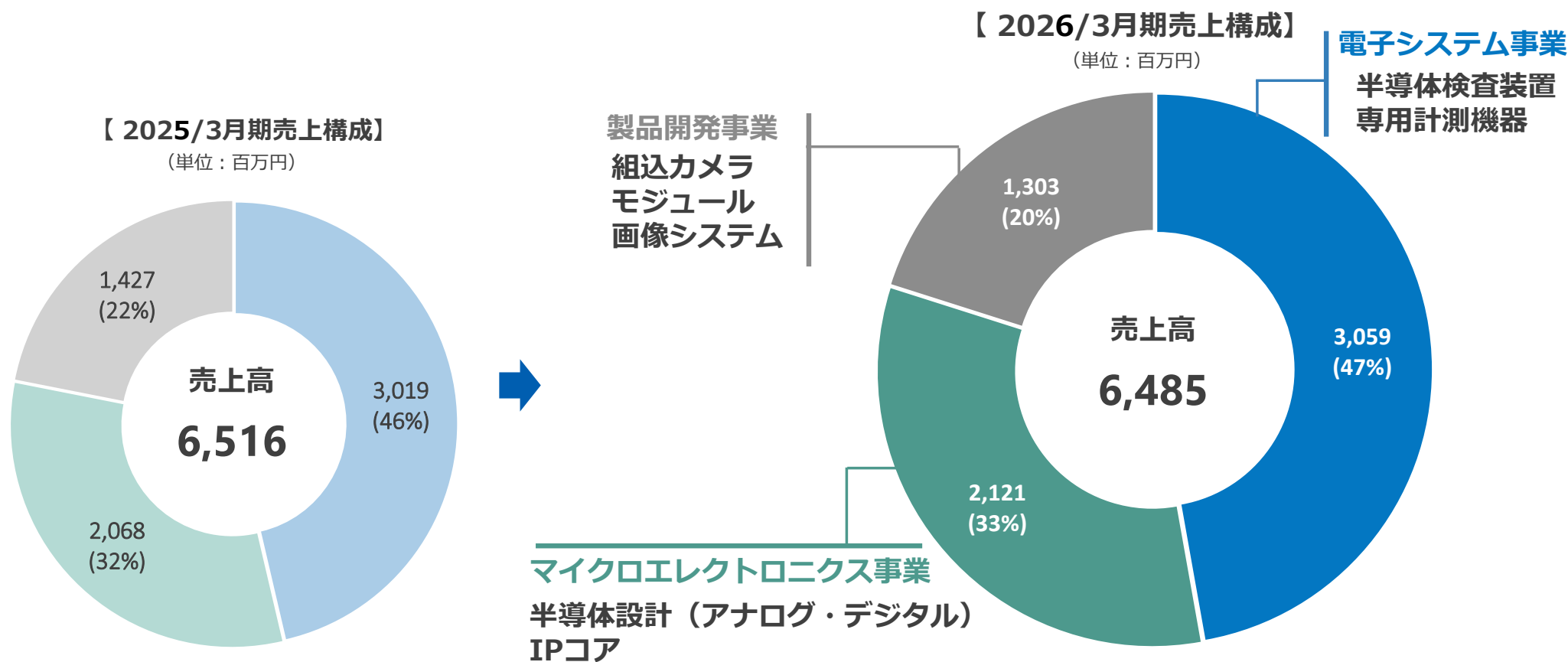
売上高及び利益とも前期比で減収・減益

- 売上高は、前期比で電子システム及びマイクロエレクトロニクスで増収となるも、製品開発で減収となり全体としても微減
- 利益は、電子システム事業、マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業の3事業ともに前期比で減益

(単位：百万円)

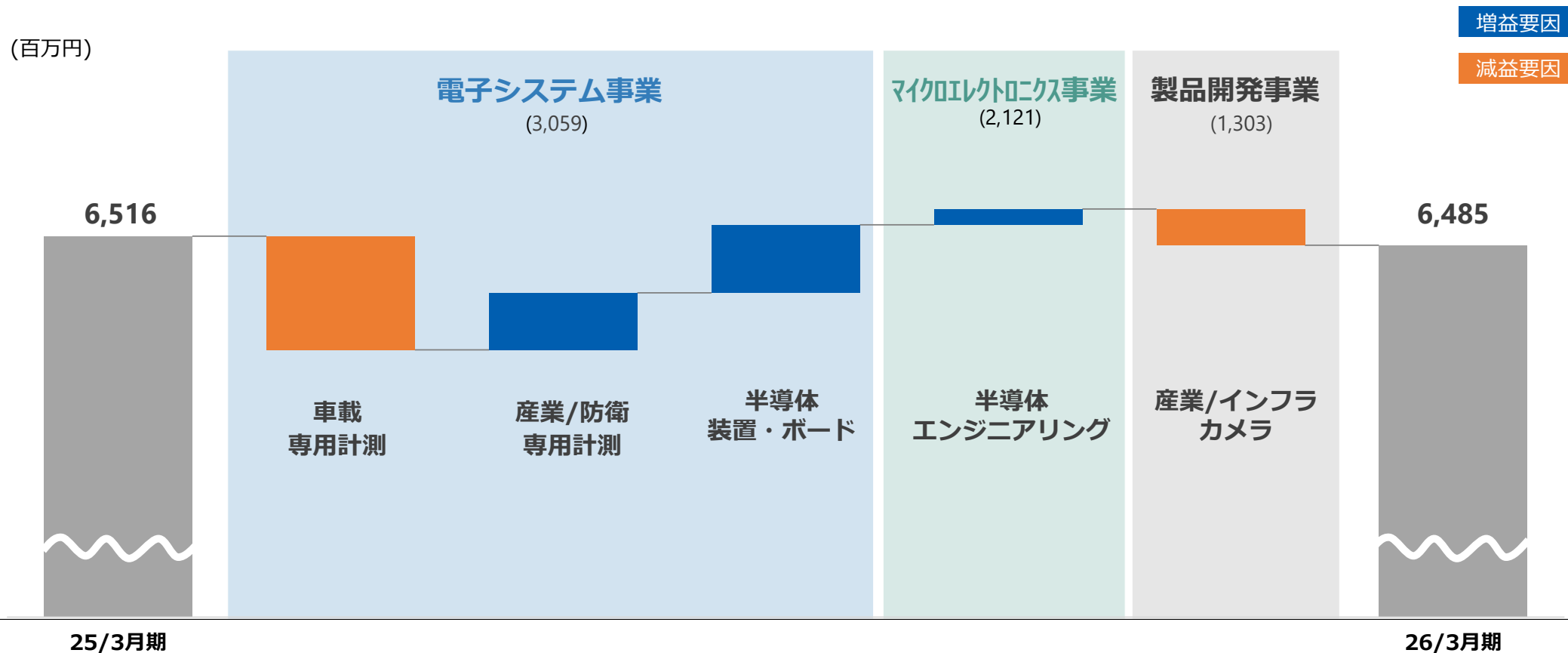
	2026/3期 通期予想 (2/12修正)		2026/3期 実績		2025/3期 通期実績	対前年 増減
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減額
売上高	6,446	100.0	6,485	100.0	6,516	△30
営業利益	△183	△2.8	△169	△2.6	56	△226
営業利益率	△2.8	-	△2.6	-	0.9	
経常利益	△180	△2.8	△165	△2.6	54	△220
当期純利益	△123	△1.9	△109	△1.7	△14	△95

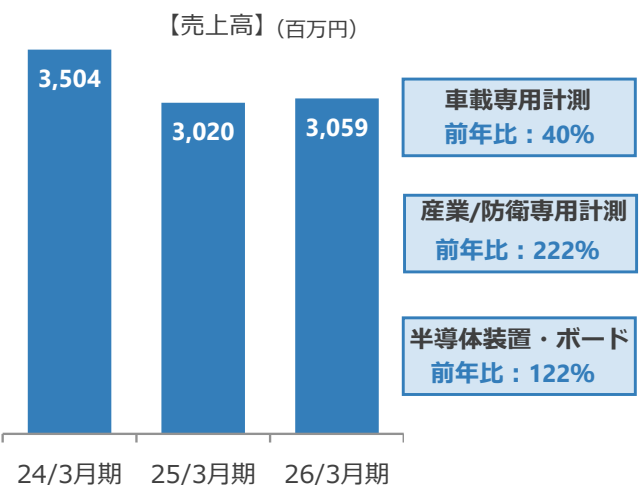
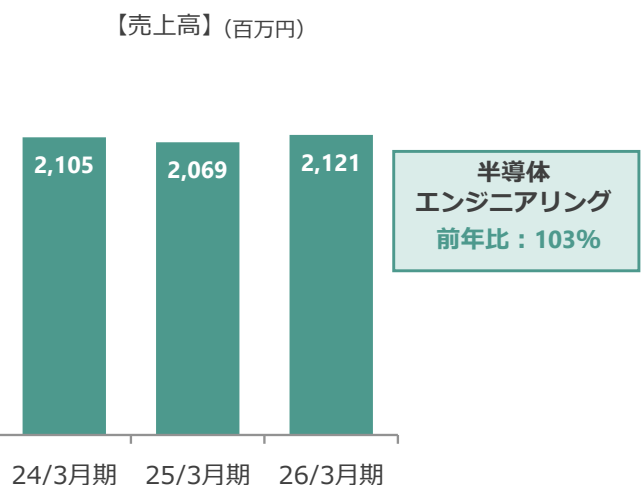
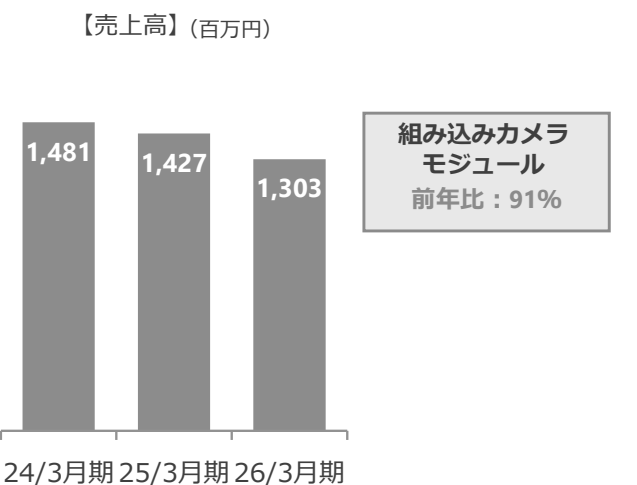
- 事業部別売上構成に大きな変化無し
- 製品開発の構成比が微減、電子システムとマイクロエレクトロニクスがそれぞれ微増



売上増減 主要因分析

- ▶ 半導体カスタム信頼性試験装置、ボード、及び防衛向け専用計測機は増収も車載専用計測装置と製品開発事業商品の受注減をカバーし切れず売上微減

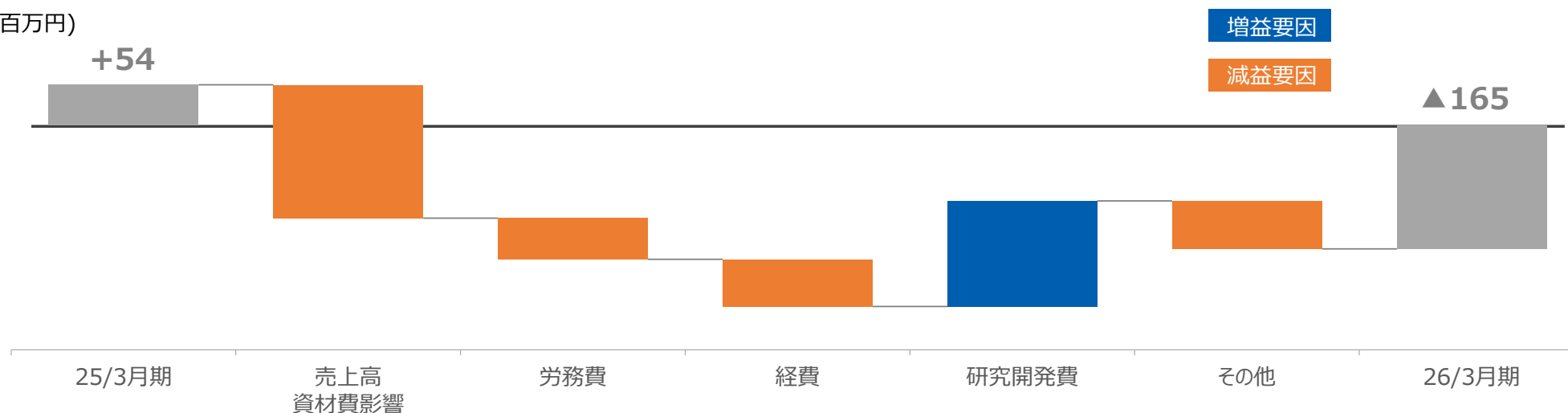


電子システム事業 +40	マイクロエレクトロニクス事業 +53	製品開発事業 ▲124																								
<ul style="list-style-type: none"> 自動車市況の不透明感継続で車載用専用計測機の受注減 産業/防衛専用計測器の新規受注増加により増収 半導体カスタム装置およびカスタムボード継続受注により増収 	<ul style="list-style-type: none"> 車載向けアナログLSI設計や海外顧客の設計は堅調に推移し増収 デジタルLSI設計は、大型案件の開発中止により減収 	<ul style="list-style-type: none"> 国内ATM、セルフレジで受注減 カード読取端末機の量産開始遅れ 海外ATM、コンビニ飲料提供機器、防衛分野で受注増 																								
<p>【売上高】(百万円)</p>  <table border="1"> <caption>【売上高】(百万円)</caption> <thead> <tr> <th>期</th> <th>売上高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/3月期</td> <td>3,504</td> </tr> <tr> <td>25/3月期</td> <td>3,020</td> </tr> <tr> <td>26/3月期</td> <td>3,059</td> </tr> </tbody> </table>	期	売上高	24/3月期	3,504	25/3月期	3,020	26/3月期	3,059	<p>【売上高】(百万円)</p>  <table border="1"> <caption>【売上高】(百万円)</caption> <thead> <tr> <th>期</th> <th>売上高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/3月期</td> <td>2,105</td> </tr> <tr> <td>25/3月期</td> <td>2,069</td> </tr> <tr> <td>26/3月期</td> <td>2,121</td> </tr> </tbody> </table>	期	売上高	24/3月期	2,105	25/3月期	2,069	26/3月期	2,121	<p>【売上高】(百万円)</p>  <table border="1"> <caption>【売上高】(百万円)</caption> <thead> <tr> <th>期</th> <th>売上高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/3月期</td> <td>1,481</td> </tr> <tr> <td>25/3月期</td> <td>1,427</td> </tr> <tr> <td>26/3月期</td> <td>1,303</td> </tr> </tbody> </table>	期	売上高	24/3月期	1,481	25/3月期	1,427	26/3月期	1,303
期	売上高																									
24/3月期	3,504																									
25/3月期	3,020																									
26/3月期	3,059																									
期	売上高																									
24/3月期	2,105																									
25/3月期	2,069																									
26/3月期	2,121																									
期	売上高																									
24/3月期	1,481																									
25/3月期	1,427																									
26/3月期	1,303																									

経常利益増減 主要因分析

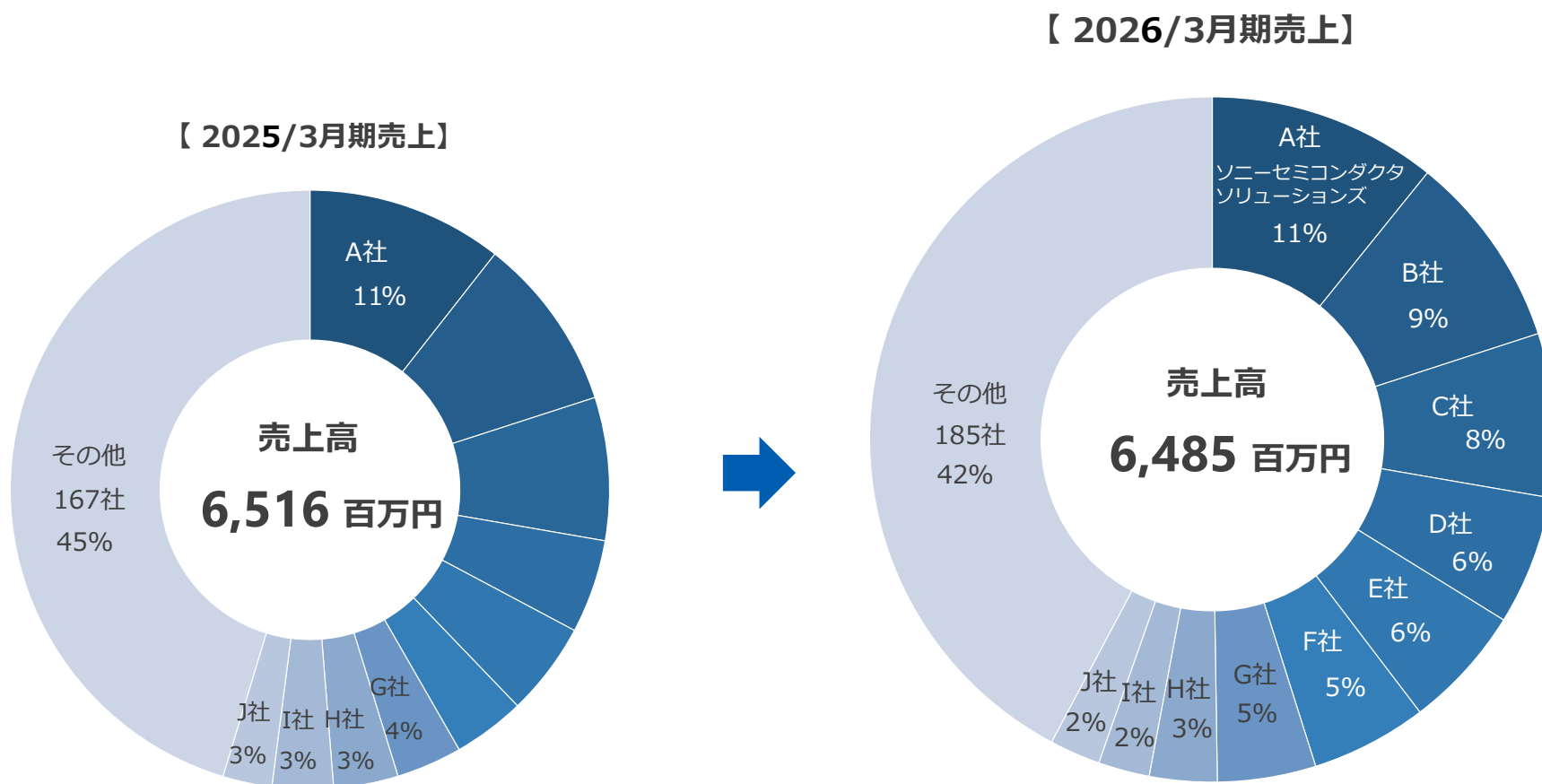
▶ 減収、商品構成の変化、資材費高騰/派遣単価アップ等、ネガティブ要因により減益

(単位：百万円)



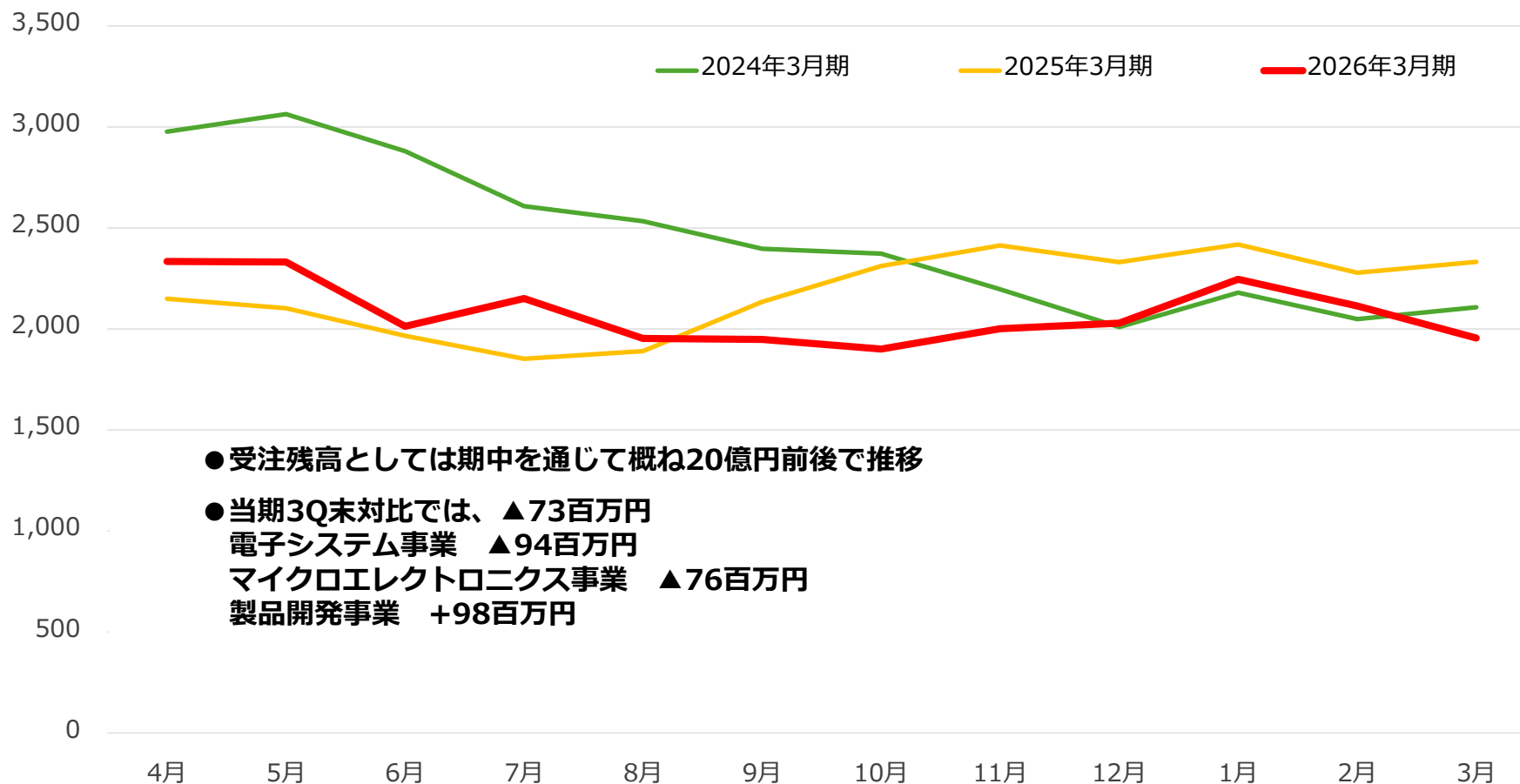
電子システム事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 半導体信頼性試験装置の商品構成変化（装置増、ボード減）、及び一部産業計測機器が開発から製造へフェーズ移行したことや資材費高騰の影響で減益
マイクロエレクトロニクス事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 増員、派遣単価アップに伴い労務費が増加し減益
製品開発事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 減収による減益

- 主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤
- 2025年度の主要10社の構成比率は58%



【受注残高（全社）】

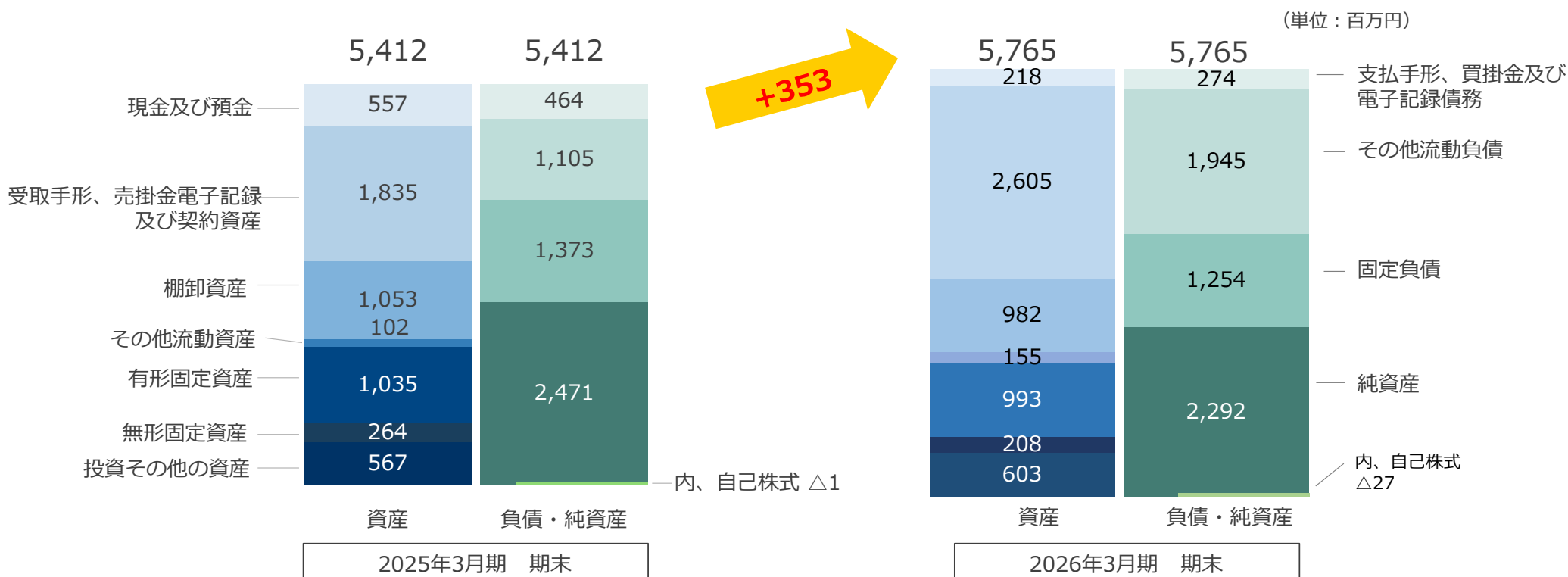
(単位：百万円)



- 受注残高としては期中を通じて概ね20億円前後で推移
- 当期3Q末対比では、▲73百万円
 電子システム事業 ▲94百万円
 マイクロエレクトロニクス事業 ▲76百万円
 製品開発事業 +98百万円

貸借対照表

- 【流動資産】 現預金338百万円減少のほか棚卸資産が71百万円減少した一方で、進行基準売上高の増加により契約資産は799百万円増加
- 【流動負債】 仕入債務89百万円減少した一方で、運転資金増加により短期借入金800百万円増加
- 【純資産】 利益剰余金176百万円減少により純資産179百万円減少。自己資本比率39.7% (△6.0pt)



2025年

4月 新製品 介護施設向けミリ波レーダー・カメラ一体型**見守りシステム C-エイド**

第三種医療機器製造販売業務（一般医療機器クラス I）許可を取得（24年10月）

→ **C-エイドをカメラのソリューション商品として強化**



C-エイド

4月 台湾半導体市場への拡販に向け **AGNEZ TECH INC.と協業開始**

→ **台湾での半導体信頼性試験装置、ボードを開拓**

6月 シキノハイテックと **e-con Systemsが協業開始**

→ **当社商品の欧米での販売、e-con Systems商品の日本販売でカメラ事業を拡大**

欧州商社 **INELTEK社と取引基本契約を締結**

→ **欧州での組み込みカメラ拡販を強化**

10月 **日本OSAT連合会（J-OSAT）に入会**

→ **日本のOSAT企業連携による半導体後工程市場の拡大を推進**

JPEG **新規格 JPEG XL のエンコーダ IP** を商品化

→ **JPEGの商品ラインナップを強化、CAST社との協業でグローバル販売を推進**



渦電流探傷器

2026年

2月 **渦電流探傷器の製品化を開始**

→ **ライセンス技術を活かし、非破壊検査ソリューションで顧客を拡大**

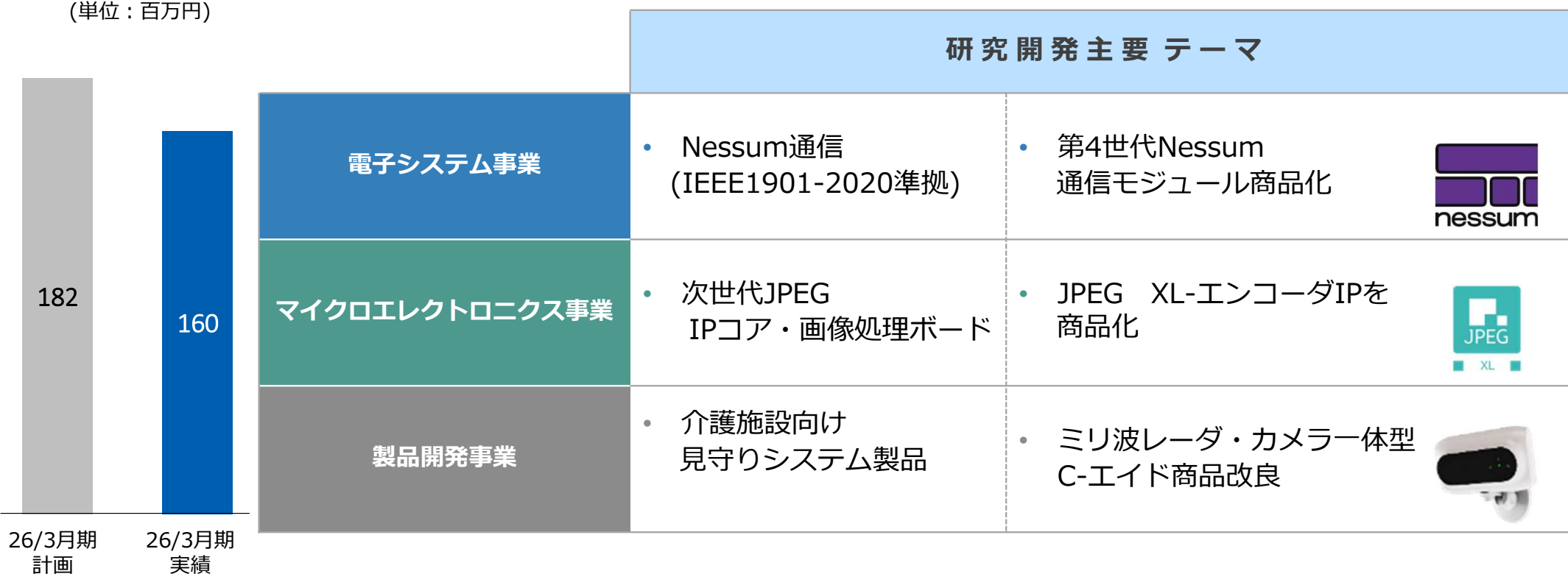
▶ 海外のパートナー連携を開始、グローバルでの顧客開拓と販路拡大を推進

電子システム事業	マイクロエレクトロニクス事業	製品開発事業
<ul style="list-style-type: none">● 半導体検査装置✓ 台湾AGNEZ TECH連携による顧客サポート強化 	<ul style="list-style-type: none">● IP✓ 米CAST社との戦略的連携 IPラインアップと販路拡大 	<ul style="list-style-type: none">● カメラモジュール✓ インドe-con Systems社と相互補完協業を通じたグローバル販売展開  <ul style="list-style-type: none">✓ ドイツ商社INELTEKと取引基本契約を締結 

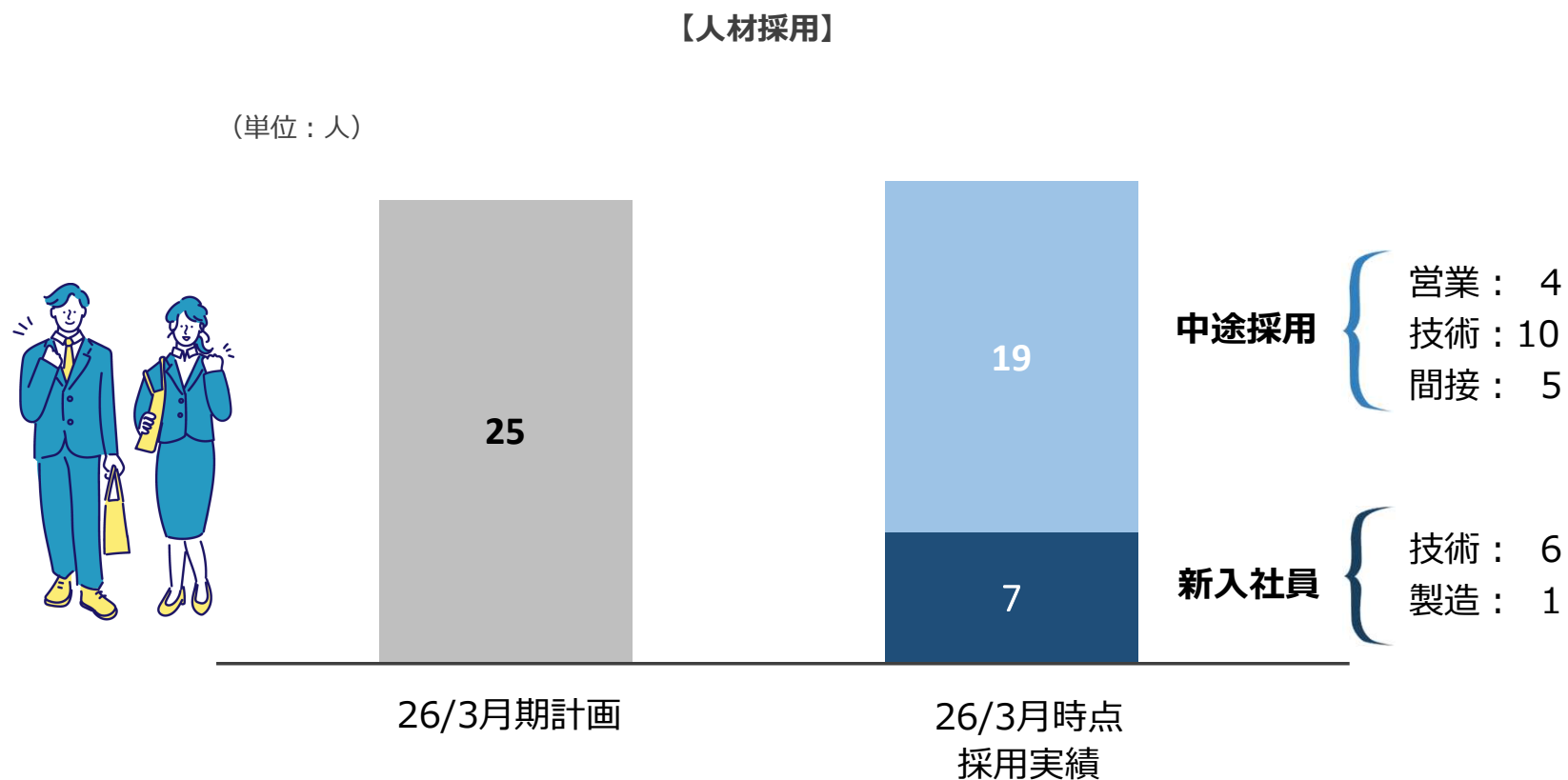
➤ 短期販売直結の研究開発テーマを選択、投資を集中し開発費を抑制

【研究開発費】

(単位：百万円)



▶ 技術職を中心に新入社員や即戦力人材を採用





3

2027年3月期通期業績予想の概要

事業環境

電子システム事業

- AIや半導体の高性能化に伴い**半導体検査・バーンイン試験**需要は、センサ、車載に加え、**データセンター・電源分野**向けが拡大
- 産業・防衛分野向け**専用計測器**は**労働力不足**や**地政学リスク**対応を背景に堅調
- 車載市場**はEV需要減速の影響を受けるも、**中長期では高性能ニーズ**が継続

マイクロエレクトロニクス事業

- 中長期の**電動車(EV+HEV)**を見据えて**車載半導体設計**需要は底堅く推移
- イメージセンサー市場の用途拡大に伴い、**センサー関連設計**需要は引き続き堅調
- タイトなメモリ需給環境**のため**画像圧縮IP**に対する需要が増加

製品開発事業

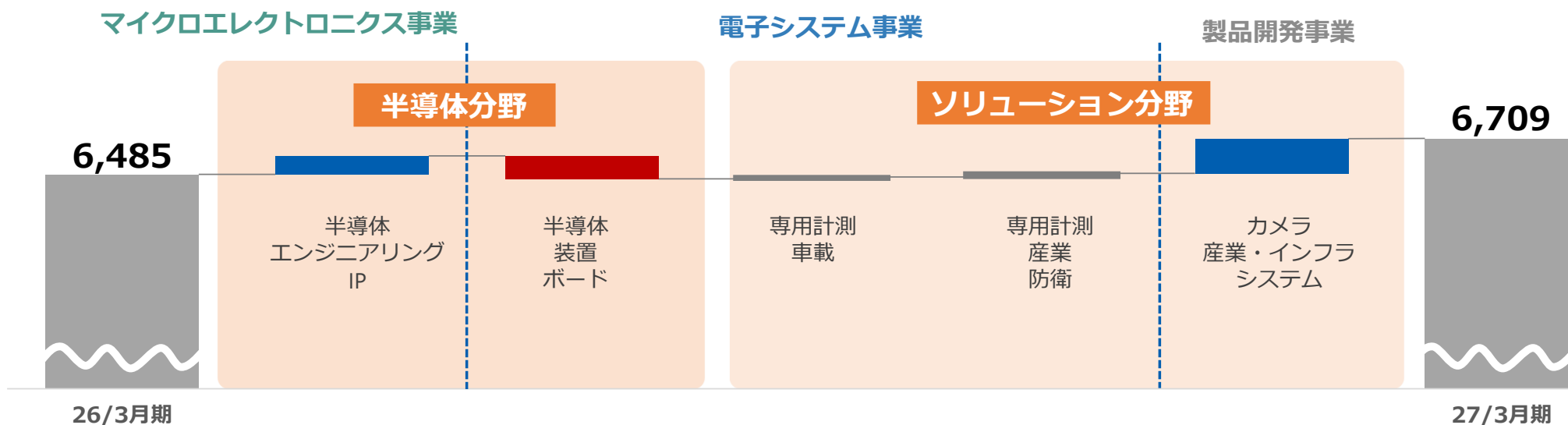
- AIの進化に伴い、**フィジカルAI**など**組み込みカメラ用途**の裾野は拡大
- 国内**ATMの減少**に伴い、**メーカーも1社**に収束方向
- 見守り機器**の需要は高齢者の増加、労働力不足対策として**介護施設**から**家庭**へと進む

当社の状況

- 半導体の個別温調**検査装置**は**需要谷間**も**ボードやデータセンター**向けの**電源モジュール**の需要は堅調
- 産業・防衛向け**専用計測機器**は、**中期の成長ドライバー**として堅調に推移
- 車載向け専用計測器**は、**Tier1メーカー**の**次世代部品完成**に向けて**仕様設計**に移行

- 車載電源**向け半導体設計は**アナログ**で堅調、**画像処理商品**向け**デジタル設計**は**国内の設計**需要が回復
- 民生用センサー**関連設計は**顧客需要**が**今期後半**から**スローダウン**
- 画像処理IPの顧客深耕に加え、**協業**を活用した**IP新規ライセンス**開拓を推進

- 協業パートナー**商品も活かし、**産業機器**向け**組み込みカメラ**は**医療・POS・コード**読取り・**建機**分野を中心に展開
- 減少の**ATM・セルフレジ**向け**カメラ**は**国内**需要を確実に取り込みつつ**海外向け**需要を見極めながら販売
- 見守り**は**協業パートナー**との**連携**を通じて販売拡大を推進



マイクロエレクトロニクス事業	<ul style="list-style-type: none"> ● アナログ：車載向けパワー半導体設計へ引続き注力すると共に海外顧客を更に拡大 ● デジタル：スマートグラスやデジタルカメラの画像処理関連での大型案件に注力 ● IP：協業を活用した国内外での販売を強化 	+112
電子システム事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 半導体検査：AI向け電源モジュールや高電力向けボードを展開、検査装置は開発谷間で昨対比減 ● 車載 専用計測機： 既存品は継続、次世代車載部品向け計測機の開発に注力 ● 産業/防衛 専用計測機： ライセンスした産業商品の拡販と防衛商品をリピート販売 	▲97
製品開発事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外協業による商品ラインアップの強化とカメラソリューション提案で増販を図る ● 見守りシステム： 介護施設に販売網を有するパートナーとの連携で増販 	+210

2027年3月期は増収増益を予想

- 電子システム事業は減収、マイクロエレクトロニクス事業及び製品開発事業は増収、全体として増収を見込む
- 利益については商品構成変化による利幅増加と増収による利益増加により増益を見込む

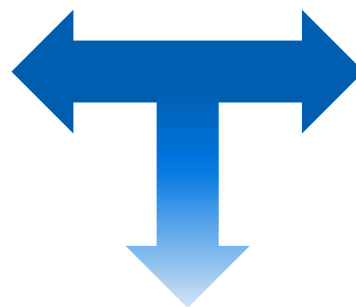
【全社】

(単位：百万円)	2026/3月期 通期実績	2027/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,485	6,709	223	3.4%
営業利益	△169	117	286	-
経常利益	△165	107	273	-
当期純利益	△109	82	191	-
研究開発費	160	220	60	37.7%

【セグメント別】

(単位：百万円)	2026/3月期 通期実績	2027/3月期通期予想	増減額	増減率
売上高	6,485	6,709	223	3.4%
電子システム事業	3,059	2,962	△97	△3.2%
マイクロエレクトロニクス事業	2,121	2,234	112	5.3%
製品開発事業	1,303	1,512	210	16.0%

将来の事業展開のための投資、
財務体質強化のための
内部保留確保



安定配当の継続実施

株主への利益還元も重視したバランス経営を推進

(単位：円)	1株当たり当期純利益および配当金	
	2026/3月期 実績	2027/3月期 予想
1株当たりの当期純利益	△24.9	18.6
中間配当金	0	0
期末配当金	15	15
年間配当金	15	15

※2026年5月15日現在において、配当予想額は、1株当たり = 15円を予定しております。

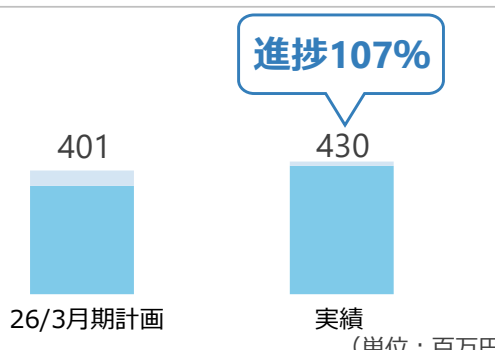
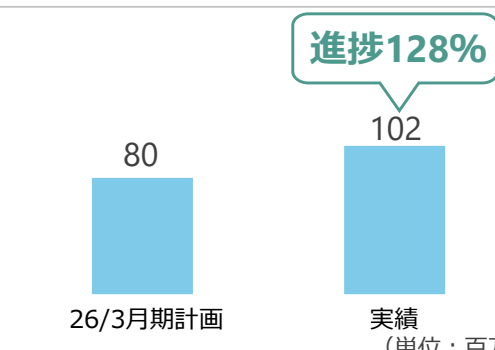
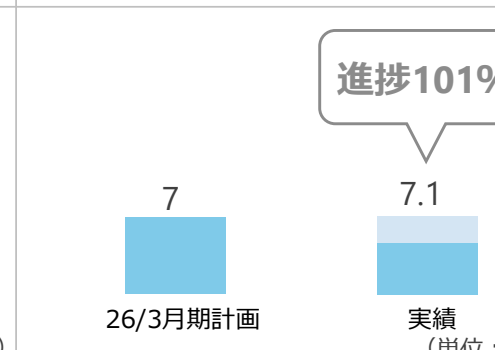


4

中期経営計画の進捗

中期計画における成長コアの進捗

➤ 既存商品を活用したオーガニック分野の進捗は順調も新商品、新分野での進捗が想定を下回る

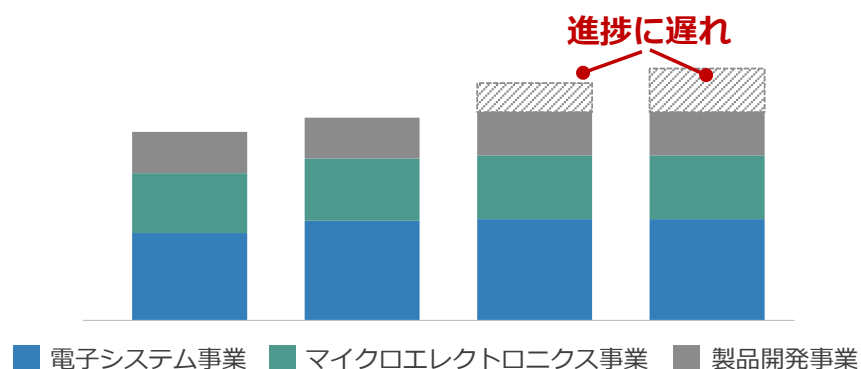
	電子システム事業	マイクロエレクトロニクス事業	製品開発事業
オーガニック	産業/防衛 <ul style="list-style-type: none"> 専用計測機が堅調に推移 	海外 <ul style="list-style-type: none"> 主要顧客との取引継続、拡大 北米大手の新規案件受注 	ソリューション <ul style="list-style-type: none"> 見守りシステム「C-エイド」全国拡販を開始も販売遅延
非オーガニック	Nessum <ul style="list-style-type: none"> 第4世代開発・認証取得完了 量産開始は今期以降 	新IP/自社デバイス <ul style="list-style-type: none"> 新IP JPEG-XL開発完了 自社デバイスマーケティング強化 	海外 <ul style="list-style-type: none"> 当社製品をe-conへサンプル供給、欧米で拡販開始
成長コア進捗	 <p>26/3月期計画 401 実績 430 進捗107% (単位：百万円)</p>	 <p>26/3月期計画 80 実績 102 進捗128% (単位：百万円)</p>	 <p>26/3月期計画 7 実績 7.1 進捗101% (単位：百万円)</p>

成長コア = **オーガニック成長エンジン分** + 非オーガニック

中期計画全体の進捗と事業モデルの見直し

- 環境変化（外的・内的）により、新商品や新分野での販売遅延に加え、車載専用計測やEMSビジネスモデルに計画差が発生、中期計画の進捗に遅れ
- 市場・顧客を起点に成長モデルを見直し、持続的な成長軌道への回帰を推進

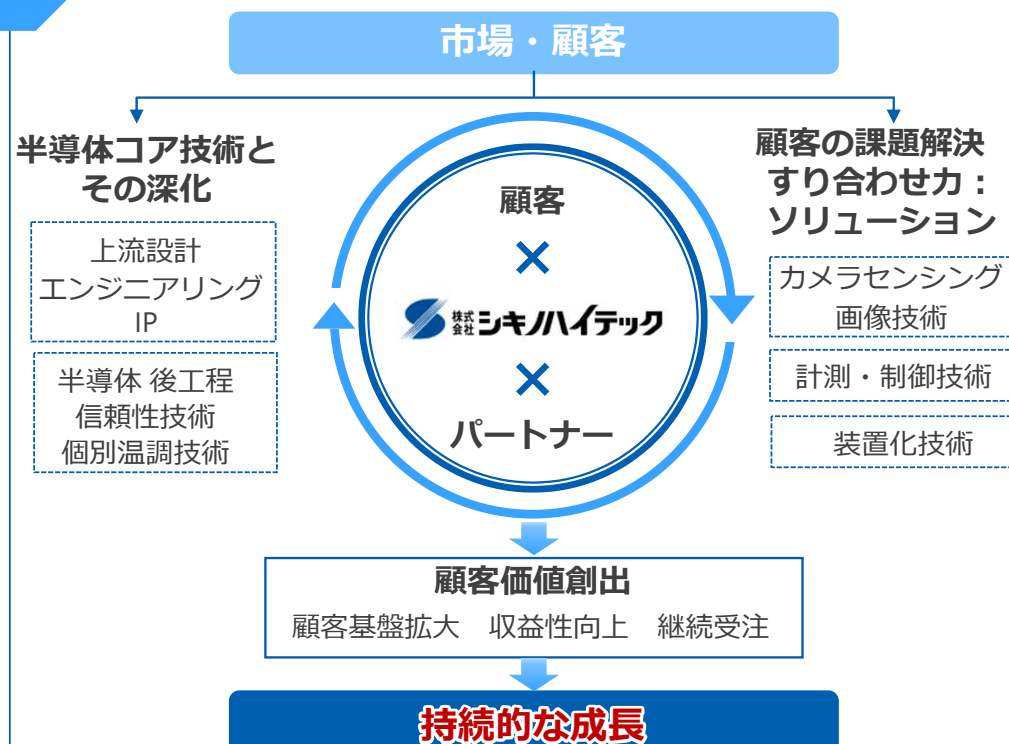
中期計画の進捗【現状】



主な課題

- 新商品（Nessum、JPEG-XL）や新分野（カメラ海外）の販売遅れ
- EV車載向け専用計測/半導体検査装置
⇒顧客投資時期シフトに加えて、投資タームが長期化
- EMS事業において民生から産業へのシフト遅れ

持続的な成長に向けて事業モデル再構築



本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役

執行役員管理本部長 舩田 敏彰

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/